



Comunicato stampa - 21/10/2022

Pack Expo International, 24 le aziende italiane presenti in collettiva a Chicago

La fiera di riferimento per l'area nordamericana torna dal 23 al 26 ottobre. Il 24 ottobre l'Italian Networking Night

Modena, 19 ottobre 2022 – Dopo 4 anni torna **Pack Expo International**, la fiera di riferimento dedicata all'industria del packaging e del processing, in programma a **Chicago dal 23 al 26 ottobre**. **Ucima** sta ultimando i dettagli della partecipazione italiana, molto nutrita e pronta a mostrare al mercato statunitense e ai buyer di tutto il mondo il meglio della tecnologia Made in Italy.

Grazie al supporto di ICE-Agenzia, l'Associazione sarà presente in fiera con 2 stand di rappresentanza per fornire assistenza alle imprese italiane e con una **collettiva di ben 24 aziende italiane** che si aggiungono alle circa settanta presenti in maniera autonoma.

Le 24 aziende che esporranno all'interno della collettiva sono **Altech, Axtra, Bonfiglioli Engineering, Cepi, Easysnap, Gasparin Brevetti, Fabbri Group, Geo Project Industries, Gorreri, Gualapack, Ilpra, Imeta, Lawer, LM, Minipan, Mp Elettronica, Pozzi Packaging, Rejves Machinery, Ricciarelli, Stalam, Technowrapp, Tropical Food Machinery, TT Italy e Vetromeccanica**.

*"C'è molta voglia di tornare a Pack Expo – dichiara il **Presidente di Ucima Riccardo Cavanna** -. Si tratta di un palcoscenico internazionale di grande prestigio, che ci farà toccare il polso del mercato nordamericano, che nel 2021 è valso il 16% del fatturato del nostro export, con una crescita del 13% sull'anno precedente, un balzo particolarmente significativo. Siamo pronti a riallacciare rapporti e a crearne di nuovi, convinti delle nostre soluzioni, che 4 anni dopo tornano oltreoceano con nuove applicazioni digitali e sistemi per la servitization".*

Ucima organizza, sempre in collaborazione con ICE, anche **Italian Networking Night**, in programma **la sera di lunedì 24 ottobre** presso il **Chicago Athletic Association Hotel**. Il Presidente Cavanna e Tom Egan, vicepresidente Industry Services della PMMI, l'associazione americana dei costruttori di macchine per l'imballaggio che organizza la fiera, si confronteranno sui temi che coinvolgono il settore in questa fase storica come la sostenibilità, la servitization, l'IoT e la digitalizzazione. Alla serata parteciperà Thomas Botzios, console generale di Chicago.